

半导体

存储模拟拐点或现，智驾+光子芯片风起云涌

上周（02/17-02/21）**半导体行情领先于主要指数**。上周创业板指数上涨 2.99%，上证综指上涨 0.97%，深证综指上涨 2.25%，中小板指上涨 2.58%，万得全 A 上涨 2.06%，申万半导体行业指数上涨 8.36%。**半导体各细分板块全部上涨，半导体制造板块涨幅最大，其他板块跌幅最大**。半导体细分板块中，封测板块上周上涨 3.2%，半导体材料板块上周上涨 4.4%，分立器件板块上周上涨 3.4%，IC 设计板块上周上涨 6.8%，半导体设备板块上周上涨 8.8%，半导体制造板块上周上涨 10.4%，其他板块上周上涨 2.5%。

存储板块预期 2 季度开启涨价。智能手机与 PC 行业对 NAND 存储的需求持续升温，新硬件产品的发布预示着消费者换机热潮的到来。随着销售渠道库存逐渐消化至合理水平，业界普遍认为，从第二季度开始，存储价格上涨的可能性显著增加。这一系列市场动态表明，存储市场的价格格局或将迎来快速变化。

模拟板块中汽车工控领域拐点或现，建议关注。模拟芯片大厂 ADI 近日公布的 2025 财年第一季度（截至 2025 年 2 月 1 日）业绩超出分析师预期，并表示将从一季度开始恢复增长。ADI 首席财务官表示，第一季度的订单量继续呈现逐步改善的态势，工业和汽车领域的强劲表现将使 ADI 在第二财季实现环比和同比增长，相信 2025 财年 ADI 将回归增长。

智能驾驶板块热度凸显，关注 A 股相关核心标的。建议关注：韦尔股份、思特威、地平线、黑芝麻等公司机会。我们看好 2025 年比亚迪发力为智驾领域的最大变量。2024 年比亚迪发布“整车智能”战略，表示将在智能化领域投入 1000 亿元，同时内部负责自研智驾的两大部门——天璇开发部、天狼研发部完成整合，成为其自研智驾的冲刺信号。

光子芯片是 AI 数据中心未来核心发展方向，可以支持支持更大的数据容量和更远的传输距离。随着信息技术的不断进步，数据中心作为信息存储和处理的核心基础设施，其性能与效率直接影响到整个社会的运行效率和信息处理能力。传统的基于电子芯片的数据中心面临着能耗高、热量大、速度瓶颈等多重挑战。光子芯片（Photonic Chips）的出现，被视为一种革命性的解决方案，旨在通过光学而非电子方式进行数据传输和处理，以实现数据中心性能的大幅提升和能效的显著优化。

国产替代：美或加征半导体进口关税，中美科技脱钩预计持续，设备材料仍需重点关注。据彭博社消息，美国总统特朗普于当地时间 2 月 18 日透露，他可能会对进口至美国的汽车、半导体和药品征收约 25% 的关税，并计划在最早 4 月 2 日正式宣布这一决定。我们认为外部地缘政治对半导体供应链带来了较大的不确定性，而本地生产预计能降低供应链风险。我们看好半导体全产业链国产化进程，重视设备材料和零部件板块的投资机会，建议关注中微公司/拓荆科技/北方华创等。

建议关注：

- 1) 智能驾驶：韦尔股份/思特威/地平线/黑芝麻
- 2) 半导体设计：汇顶科技/思特威/扬杰科技/瑞芯微/恒玄科技/普冉股份/江波龙（天风计算机联合覆盖）/东芯股份/复旦微电/钜泉科技/晶晨股份/力合微/全志科技/乐鑫科技/寒武纪/龙芯中科/海光信息（天风计算机覆盖）/北京君正/澜起科技/聚辰股份/帝奥微/纳芯微/圣邦股份/中颖电子/斯达半导/宏微科技/东微半导/民德电子/思瑞浦/新洁能/兆易创新/韦尔股份/艾为电子/卓胜微/晶丰明源/希荻微/安路科技/中科蓝讯
- 3) 半导体材料设备零部件：雅克科技/鼎龙股份（天风化工联合覆盖）/和远气体/正帆科技（天风机械联合覆盖）/北方华创/富创精密/精智达/沪硅产业/上海新阳/中微公司/安集科技/盛美上海/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/凯美特气/金海通（天风机械联合覆盖）/鸿日达/精测电子（天风机械联合覆盖）/天岳先进/国力股份/新莱应材/长川科技（天风机械覆盖）/联动科技/茂莱光学/艾森股份/江丰电子
- 4) IDM 代工封测：伟测科技/中芯国际/华虹半导体/长电科技/通富微电/时代电气/士兰微/扬杰科技/闻泰科技/三安光电
- 5) 卫星产业链：海格通信（天风通信覆盖）/电科芯片/复旦微电/北斗星通/利扬芯片
- 6) 光子芯片：迈信林、源杰科技、长光华芯、仕佳光子、杰普特、炬光科技

风险提示：地缘政治带来的不可预测风险，需求复苏不及预期，技术迭代不及预期，产业政策变化风险

证券研究报告
2025 年 02 月 26 日

投资评级

行业评级 强于大市(维持评级)
上次评级 强于大市

作者

潘暕 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517070005
panjian@tfzq.com

骆奕扬 分析师
SAC 执业证书编号：S1110521050001
luoyiyang@tfzq.com

程如莹 分析师
SAC 执业证书编号：S1110521110002
chengruiying@tfzq.com

李泓依 分析师
SAC 执业证书编号：S1110524040006
lihongyi@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

- 1 《半导体-行业研究周报:美对华半导体出口管制落地,A 股进入业绩预告期》2025-02-12
- 2 《半导体-行业点评:台积电限制大陆 IC 设计流片封装, 国产替代有望加速》2025-02-10
- 3 《半导体-行业研究周报:美对华半导体出口管制落地,A 股进入业绩预告期》2025-01-22

内容目录

1. 周观点：存储模拟拐点或现，智驾+光子芯片风起云涌.....	5
2. 半导体产业宏观数据：半导体增长或趋缓，中美市场是核心.....	6
3. 2025年1月芯片交期及库存：整体芯片交期趋稳.....	7
4. 2025年1月产业链各环节景气度：.....	13
4.1. 设计：库存去化效益显现，需求复苏有望带动基本面持续向好.....	13
4.1.1. 存储：本周存储现货市场多数价格“下探寻底”，嵌入式产品结构性分化行情延续.....	13
4.2. 代工：中国成熟制程厂商或掀起新一轮价格战，AI需求增长下部分厂商加速布局.....	19
4.3. 设备材料零部件：1月，可统计中标设备数量22台，无可统计招标设备.....	20
4.3.1. 设备及零部件中标情况：1月可统计中标设备数量22台，同比-18.5%...20	
4.3.2. 设备招标情况：无可统计招标设备.....	23
4.4. 分销商：2025年分销市场订单预期乐观，关注日系分销商加大在中国半导体市场采购和布局.....	24
5. 终端应用：看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势.....	25
5.1. 消费电子：预计2025年折叠屏手机市场增速放缓，关注海外农业无人机市场增长机会。.....	25
5.2. 新能源汽车：汽车头部厂商格局分化，海外市场增长相对低迷。.....	25
5.3. 工控：中国工控市场需求增长较快，国产替代快速提升。.....	26
5.4. 光伏：受光伏产业链价格持续低位影响，头部厂商订单增长低迷。.....	26
5.5. 储能：储能行业订单增长稳定，低价竞争下部分企业营收波动明显。.....	27
5.6. 服务器：中国AI新创DeepSeek增长强劲，全球AI产业迎来变革。.....	27
5.7. 通信：通信市场订单低迷延续，关注中国三大运营商5G-A商用对供应链影响。.....	27
6. 上周（02/17-02/21）半导体行情回顾.....	28
7. 上周（02/17-02/21）重点公司公告.....	29
8. 上周（02/17-02/21）半导体重点新闻.....	29
9. 风险提示.....	30

图表目录

图1：全球半导体销售额.....	6
图2：中国集成电路产量.....	6
图3：中国半导体（SW）行业指数.....	6
图4：费城半导体指数（SOX）.....	6
图5：电子（申万）各板块涨跌幅（2025年1月）.....	7
图6：电子（申万）各板块涨跌幅（2024年1-12月）.....	7
图7：全球芯片平均交货周期（周）.....	7
图8：头部厂商2025年1月订单及库存.....	12
图9：NAND价格指数.....	13

图 10: DRAM 价格指数.....	13
图 11: Flash Wafer 最新报价 (当前价为美元) (02/11)	14
图 12: DDR 最新报价 (当前价为美元) (02/11)	14
图 13: 渠道市场 SSD 最新报价 (当前价为美元) (02/11)	14
图 14: 行业市场 SSD 最新报价 (当前价为美元) (02/11)	14
图 15: 渠道市场内存条最新报价 (当前价为美元) (02/11)	15
图 16: 行业市场内存条最新报价 (当前价为美元) (02/11)	15
图 17: eMMC 最新报价 (当前价为美元) (02/11)	15
图 18: LPDDR 最新报价 (当前价为美元) (02/11)	15
图 19: UFS 最新报价 (当前价为美元) (02/11)	15
图 20: uMCP 最新报价 (当前价为美元) (02/11)	15
图 21: eMCP 最新报价 (当前价为美元) (02/11)	16
图 22: HBM 制程发展.....	16
图 23: HBM 比重转进 (依位元计算)	17
图 24: 三星等厂商占 DDR3 市场主要份额	17
图 25: DDR3 价格走势一览 (元)	18
图 26: 24Q2-24Q3 NAND FLASH 产品合约价涨跌幅预测	19
图 27: 24Q3-24Q4 DRAM 产品合约价涨跌幅预测	19
图 28: 主要晶圆代工厂动态	19
图 29: 主要封测厂商动态	20
图 30: 半导体设备及硅晶圆头部企业情况	20
图 31: 2025 年 1 月部分国内企业可统计中标情况 (台)	20
图 32: 2020-2025.1 北方华创可统计中标情况 (台)	21
图 33: 2023 年北方华创各主要设备类型中标分布情况 (台)	21
图 34: 2024 年 1-12 月北方华创各主要设备类型中标分布情况 (台)	21
图 35: 2011-2025.1 国内半导体设备零部件可统计中标情况 (台)	21
图 36: 2011-2025.1 国外半导体设备零部件可统计中标情况 (台)	22
图 37: 2020-2025.1 华虹宏力可统计招标情况 (台)	23
图 38: 2023 年华虹宏力各主要设备类型中标分布情况 (台)	24
图 39: 2024 年 1-12 月华虹宏力各主要设备类型中标分布情况 (台)	24
图 40: 主要元器件分销商最新动态.....	24
图 41: 上周 A 股各行业行情对比 (%)	28
图 42: 上周子板块涨跌幅 (%)	28
表 1: 头部厂商 2025 年 1 月交期及趋势	8
表 2: 头部存储厂商减产 DDR3.....	17
表 3: 部分国产 DDR3 量产厂商情况.....	18
表 4: 消费电子厂商最新动态.....	25
表 5: 新能源汽车厂商最新动态	25
表 6: 工控厂商最新动态.....	26
表 7: 光伏厂商最新动态.....	26

表 8: 储能厂商最新动态.....	27
表 9: 服务器厂商最新动态	27
表 10: 通信厂商最新动态	28
表 11: 上周半导体行情与主要指数对比.....	28
表 12: 上周涨跌幅前十半导体个股.....	29

1. 周观点：存储模拟拐点或现，智驾+光子芯片风起云涌

存储板块预期 2 季度开启涨价。智能手机与 PC 行业对 NAND 存储的需求持续升温，新硬件产品的发布预示着消费者换机热潮的到来。随着销售渠道库存逐渐消化至合理水平，业界普遍认为，从第二季度开始，存储价格上涨的可能性显著增加。这一系列市场动态表明，存储市场的价格格局或将迎来快速变化。

模拟板块中汽车工控领域拐点或现，建议关注。模拟芯片大厂 ADI 近日公布的 2025 财年第一季度（截至 2025 年 2 月 1 日）业绩超出分析师预期，并表示将从一季度开始恢复增长。ADI 首席财务官表示，第一季度的订单量继续呈现逐步改善的态势，工业和汽车领域的强劲表现将使 ADI 在第二财季实现环比和同比增长，相信 2025 财年 ADI 将回归增长。

智能驾驶板块热度凸显，关注 A 股相关核心标的。建议关注：韦尔股份、思特威、地平线、黑芝麻等公司机会。我们看好 2025 年比亚迪发力为智驾领域的最大变量。2024 年比亚迪发布“整车智能”战略，表示将在智能化领域投入 1000 亿元，同时内部负责自研智驾的两大部门——天璇开发部、天狼研发部完成整合，成为其自研智驾的冲刺信号。

光子芯片是 AI 数据中心未来核心发展方向。随着信息技术的不断进步，数据中心作为信息存储和处理的核⼼基础设施，其性能与效率直接影响到整个社会的运行效率和信息处理能力。传统的基于电子芯片的数据中心面临着能耗高、热量大、速度瓶颈等多重挑战。光子芯片（Photonic Chips）的出现，被视为一种革命性的解决方案，旨在通过光学而非电子方式进行数据传输和处理，以实现数据中心性能的大幅提升和能效的显著优化。

端侧：信通院启动 AI 眼镜专项测试，推动行业规范化，有望加速市场渗透，持续看好 AI 眼镜产业链。

AI 眼镜行业催化不断，2 月 19 日，根据中国信通院泰尔终端实验室，中国信通院发布全球首个 AI 眼镜评测体系，覆盖 7 大模块、超 60 项指标，我们认为测评体系有望推动行业规范化，进而加速 AI 眼镜的市场渗透。此外，根据 AING 硬迹公众号，中国移动计划于 25 年一季度推出三款 AI 眼镜，中国电信的 AI 眼镜或于 25 年 5 月面世，我们预计运营商的产品推出，依托其丰富的线下渠道，有望让消费者更快接受 AI 眼镜这一新兴产品，加速行业发展，持续看好 AI 眼镜产业链，建议关注小米集团/英派斯/恒玄科技/中科蓝讯等。

算力：阿里资本开支计划超预期，预计国产算力芯片需求持续旺盛，持续看好中芯国际。

阿里巴巴发布 3QFY25 财报并召开业绩会，3QFY25 公司资本开支达到 318 亿元，环比大幅提升 143 亿元，公司认为 AI 时代对于基础设施有明确而巨大的需求，宣布未来三年集团在云和 AI 的基础设施投入预计将超越过去十年的总和，FY2015-FY2024 公司资本开支合计 2693.83 亿元，公司未来三年资本开支计划超预期。此前海外大厂如谷歌、META、亚马逊、微软等均释放了乐观的资本开支展望，我们预计 25 年全球算力芯片或将受益于 AI 资本开支趋势而需求持续旺盛，国产算力芯片受益于国产替代的趋势需求增长有望好于全球平均，建议关注中芯国际等

国产替代：美或加征半导体进口关税，中美科技脱钩预计持续，半导体自主可控仍是长期方向。

据彭博社消息，美国总统特朗普于当地时间 2 月 18 日透露，他可能会对进口至美国的汽

车、半导体和药品征收约 25%的关税，并计划在最早 4 月 2 日正式宣布这一决定。我们认为外部地缘政治对半导体供应链带来了较大的不确定性，而本地生产预计能够降低供应链风险。我们看好半导体全产业链国产化进程，重视设备材料和零部件板块的投资机会，建议关注中微公司/拓荆科技/北方华创等。

2. 半导体产业宏观数据：半导体增长或趋缓，中美市场是核心

根据 WSTS 数据，2024 年全球半导体销售额约 6268.7 亿美元，同比增长 19%。WSTS 表示，全球半导体市场正式告别下行周期，步入复苏轨道。中国市场看，SIA 预计 2024 年中国半导体销售额超 1700 亿美元。CSAID（中国半导体行业协会集成电路设计分会）数据显示 2024 年中国芯片设计销售额 6460.4 亿元（约 909.9 亿美元），长三角地区占比超过 50%，上海以 1795 亿元产值位居国内第一。从销售额过亿产值厂商看，2024 年达 731 家，同比增加 106 家，增长 17%。具体的产品品类看，通信芯片和消费类电子芯片份额占总销售额的 68.48%，超过三分之二。总的来看，中国芯片增长保持稳定，但产品处于市场中低端局面尚未改变。

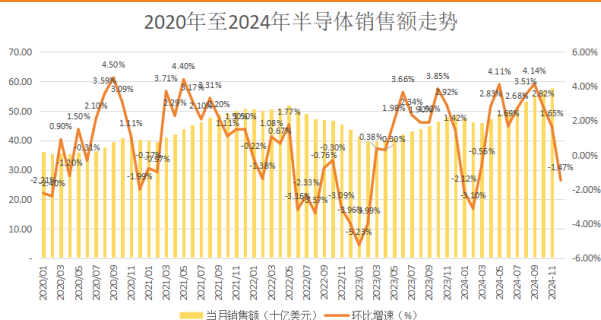
从全球半导体销售额看，2024 年受中美为代表的核心市场增长推动，全球半导体行业复苏强劲，WSTS 最新数据将其增速由此前的 12.5%上调至 19.0%。从 2025 年全球半导体销售额预测看，主流机构预测在 6%-15.6%之间，相较于 2024 年放缓明显。

从区域市场看，WSTS 数据显示，2024 年以德国为代表的欧洲市场萎缩较大，同比下滑 6.7%；北美和亚太市场（除日本外）增长强劲，同比增速分别达 38.9%、17.5%。2025 年，WSTS 预测北美和亚太市场仍是最主要的增量市场，中国和美国增长预期乐观。

细分品类看，WSTS 预计 2025 年增速最快的前三名是逻辑、存储和传感器，分别增长 16.8%、13.4%和 7.0%。相较于 2024 年，存储产品增速回调明显，AI 增长驱动下逻辑芯片增速快速上升。受汽车和工业需求影响，微处理器/控制器、分立器件分别增长 5.6%、5.8%。模拟芯片触底回升明显，同比增长 4.7%。

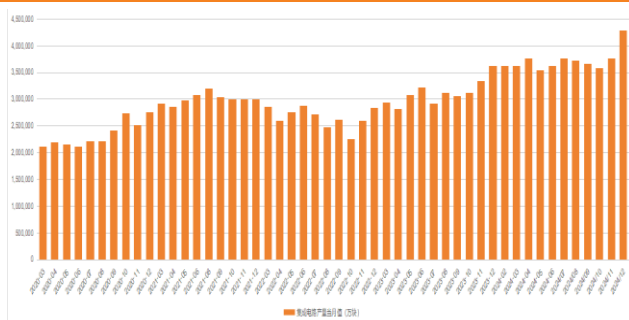
半导体产业宏观数据：根据 SIA 的最新数据，根据 SIA 最新数据，2024 年 12 月全球半导体市场销售额为 569.7 亿美元，同比增长 17.1%。2024 年度总销售额达 6276 亿美元，同比增长 19.1%，首次突破 6000 亿美元，创下历史最高记录，预计 2025 年市场增长将超过两位数。

图 1：全球半导体销售额



资料来源：SIA，芯八哥公众号，天风证券研究所

图 2：中国集成电路产量

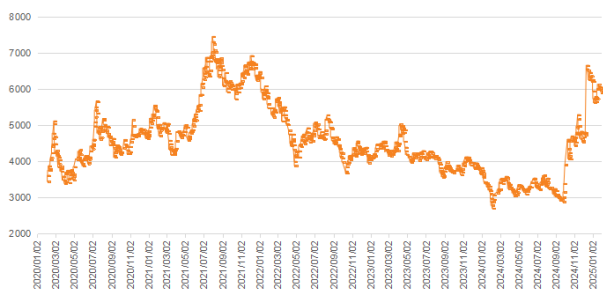


资料来源：工信部，SIA，芯八哥公众号，天风证券研究所

半导体指数走势：2025 年 1 月，中国半导体（SW）行业指数下跌 0.74%，2025 年 1 月，费城半导体指数（SOX）上涨 0.72%。

图 3：中国半导体（sw）行业指数

图 4：费城半导体指数（sox）



资料来源：iFinD，天风证券研究所

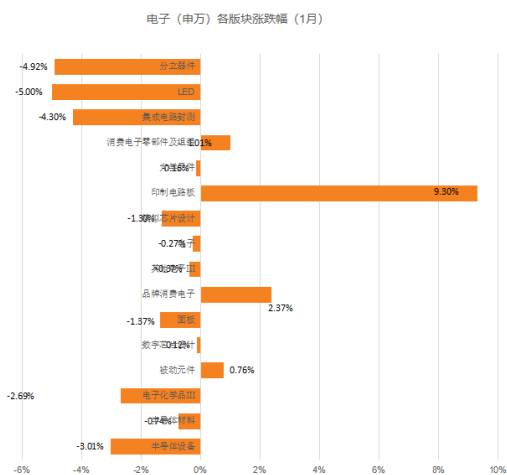


资料来源：iFinD，天风证券研究所

2025年1月，申万指数各电子细分板块有涨有跌。涨幅居前三名分别为印制电路板（9.30%）、品牌消费电子（2.37%）、印制被动元件（0.76%）。

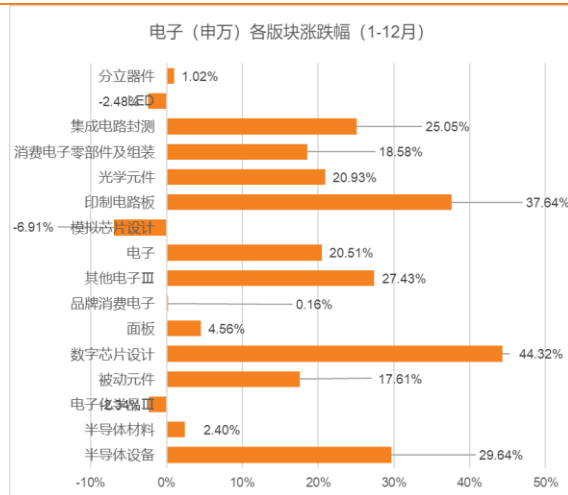
2024年1-12月，申万指数各电子细分板块大部分上涨。涨幅居前三名分别为数字芯片设计（44.32%）、印制电路板（37.64%）、半导体设备（29.64%）。

图 5：电子（申万）各板块涨跌幅（2025 年 1 月）



资料来源：iFinD，天风证券研究所

图 6：电子（申万）各板块涨跌幅（2024 年 1-12 月）

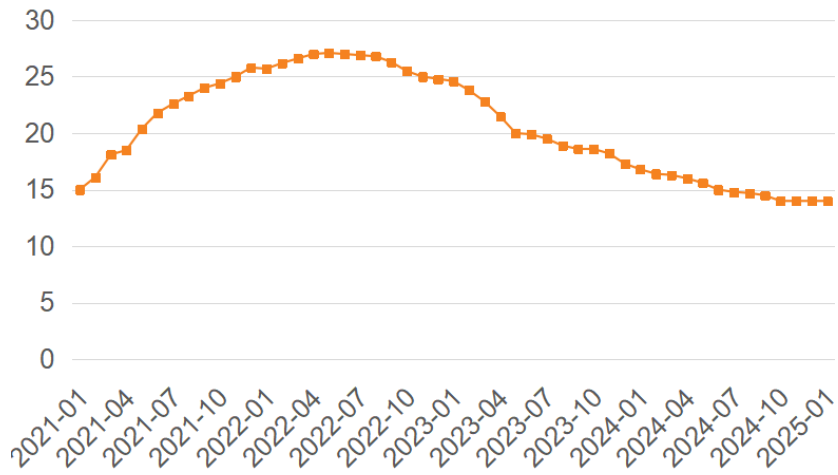


资料来源：iFinD，天风证券研究所

3. 2025 年 1 月芯片交期及库存：整体芯片交期趋稳

整体芯片交期趋势：1 月，整体芯片交期保持稳定，回顾全年芯片交期基本回归常态，但受库存影响部分品类库存比预期严重。

图 7：全球芯片平均交货周期（周）



资料来源：芯八哥公众号，Susquehanna Financial Group，天风证券研究所

重点芯片供应商交期：1月主要芯片厂商交期和价格趋稳。由于订相对低迷，包括模拟器件、MCU、分立器等主要产品交期触底明显，价格未见改件善。值得关注的是，消费类存储价格持续低迷，后续头部厂商减产报价下行情或有波动。

表 1：头部厂商 2025 年 1 月交期及趋势

类别	供应商	产品	25.1 交期/周	25.2 交期/周	交期趋势	价格趋势
模拟	AMS OSRAM	传感器	8-24	8-24	稳定	根据市场调整
	BOSCH	传感器	6-12	6-12	稳定	稳定
	Diodes	多源模拟/电源	10-18	10-18	稳定	稳定
		开关稳压器	10-18	10-18	稳定	稳定
	FTDI Chip	接口	10-14	10-14	稳定	稳定
	Infineon	传感器	4-26	4-26	稳定	稳定
		开关稳压器	14-24	14-24	稳定	稳定
		汽车模拟和电源	20-24	20-24	稳定	稳定
	ADI (Maxim)	放大器和数据转换器	12-20	12-20	稳定	稳定
		接口	8-12	8-12	稳定	稳定
		开关稳压器	10-14	10-14	稳定	稳定
	Microchip	放大器和数据转换器	4-10	4-10	稳定	稳定
		定时	7-12	7-12	稳定	稳定
		开关稳压器	8-20	8-20	稳定	稳定
	MPS	开关稳压	12-24	12-24	稳定	稳定

		器				
	NXP	传感器	16-52	16-52	稳定	稳定
		接口	16-20	16-20	稳定	稳定
		汽车模拟和电源	16-20	16-20	稳定	稳定
	onsemi	传感器	18-52	18-52	稳定	根据市场调整
		放大器和数据转换器	10-16	10-16	稳定	稳定
		定时	20-30	20-30	延长	稳定
		多源模拟/电源	10-18	10-18	稳定	稳定
		开关稳压器	10-20	10-20	稳定	稳定
	Panasonic	传感器	16-26	16-26	延长	稳定
	Renesas	放大器和数据转换器	12-18	12-18	稳定	稳定
		定时	12-24	12-24	稳定	稳定
		接口	14-18	14-18	稳定	稳定
		开关稳压器	14-24	14-24	缩短	稳定
	ROHM	传感器	24-52	24-52	稳定	上升
		开关稳压器	12-26	12-26	稳定	稳定
	ST	传感器	20-34	20-34	稳定	稳定
		放大器和数据转换器	10-16	10-16	稳定	稳定
		多源模拟/电源	10-18	10-18	稳定	稳定
		开关稳压器	10-20	10-20	稳定	稳定
		汽车模拟和电源	16-18	16-18	稳定	稳定
	TE	传感器	16-52	16-52	稳定	根据市场调整
	Vishay	传感器	24-52	24-52	延长	稳定
射频和无线	Infineon	蓝牙模块	16-24	16-24	稳定	稳定
	Microchip	WiFi 模块	12-20	12-20	稳定	稳定
		蓝牙模块	12-20	12-20	稳定	稳定
		收发器/接收器	12-20	12-20	稳定	稳定
	Murata	WiFi 模块	26-50	26-50	稳定	稳定
		蓝牙模块	26-50	26-50	稳定	稳定
	Larid	WiFi 模块	16-30	16-30	稳定	稳定
天线		12-16	12-16	稳定	稳定	

分立器件	ST	蓝牙模块	10-12	10-12	稳定	稳定
		收发器/接收器	12	12	稳定	稳定
		RFID	20	20	稳定	稳定
	NXP	收发器/接收器	24	24	稳定	稳定
		RFID	13	13	稳定	稳定
		大功率 IC	12-16	12-16	稳定	稳定
	onsemi	蓝牙模块	16-30	16-30	稳定	稳定
	Diodes	低压 MOSFET	8-18	8-18	稳定	根据市场调整
		TVS 二极管	6-12	6-12	缩短	稳定
		桥式整流器	8-15	8-15	稳定	根据市场调整
		肖特基二极管	8-12	8-12	稳定	稳定
		整流器	8-13	8-13	稳定	根据市场调整
开关二极管		8-12	8-12	稳定	稳定	
小信号 MOSFET		8-12	8-12	稳定	稳定	
齐纳二极管		8-12	8-12	稳定	稳定	
双极晶体管		8-12	8-12	稳定	稳定	
数字晶体管/RETS		8-12	8-12	稳定	稳定	
通用晶体管		8-12	8-12	稳定	稳定	
逻辑器件		8-10	8-10	稳定	稳定	
Infineon	低压 MOSFET	10-20	10-20	稳定	根据市场调整	
	高压 MOSFET	8-24	8-24	稳定	根据市场调整	
	IGBT	12-52	12-52	稳定	根据市场调整	
	宽带隙 MOSFET	8-39	8-39	稳定	根据市场调整	
	数字晶体管/RETS	6-30	6-30	稳定	稳定	
	通用晶体管	6-50	6-50	稳定	稳定	
	军用-航空晶体管	20-30	20-30	稳定	稳定	
ST	低压 MOSFET	13-32	13-32	稳定	根据市场调整	
	高压	13-26	13-26	稳定	根据市场调整	

		MOSFET				
		IGBT	14-20	14-20	稳定	根据市场调整
		ESD	16-18	16-18	缩短	稳定
		宽带隙 MOSFET	32-52	32-52	稳定	根据市场调整
		晶闸管 / Triac	15-16	15-16	稳定	稳定
		TVS 二极管	16-18	16-18	稳定	稳定
		整流器	14-16	14-16	稳定	根据市场调整
		双极晶体管	12-24	12-24	稳定	稳定
	Wingtech (Nexperia)	低压 MOSFET	6-14	6-14	稳定	根据市场调整
		ESD	6-10	6-10	缩短	稳定
		肖特基二极管	6-8	6-8	稳定	稳定
		开关二极管	6-8	6-8	稳定	稳定
		小信号 MOSFET	6-8	6-8	稳定	稳定
		齐纳二极管	6-8	6-8	缩短	稳定
		双极晶体管	6-8	6-8	稳定	稳定
		数字晶体管 / RETS	6-8	6-8	稳定	稳定
		通用晶体管	6-8	6-8	稳定	稳定
		逻辑器件	6-8	6-8	稳定	稳定
		MCU	Renesas	8 位 MCU	12	12
32 位 MCU	12			12	稳定	稳定
汽车	45			45	稳定	稳定
32 位 MPU	12			12	稳定	稳定
ST	8 位 MCU		10-24	10-24	延长	稳定
	汽车		40-52	40-52	稳定	稳定
	32 位 MPU		10-16	10-16	延长	下降
Infineon	8 位 MCU		10-26	10-26	稳定	稳定
	32 位 MCU		10-26	10-26	缩短	稳定
	汽车		紧缺	紧缺	稳定	稳定
Microchip	8 位 MCU		4-12	4-12	稳定	稳定
	32 位 MCU		4-18	4-18	稳定	稳定
	32 位 MPU		4-20	4-20	稳定	稳定
NXP	8 位 MCU		13-39	13-39	稳定	稳定
	32 位 MCU		13-39	13-39	稳定	稳定
	汽车		18-52	18-52	稳定	稳定
	32 位 MPU	18-39	18-39	稳定	稳定	

可编程逻辑器件	AMD (Xilinx)	FPGA	12-30	12-30	稳定	稳定
	Intel (Altera)		14-30	14-30	稳定	稳定
	Lattice		12-30	12-30	稳定	稳定
	Microchip (Microsemi)		8-32	8-32	稳定	稳定
存储器	Samsung	DRAM (商用 PC)	20-54	20-54	稳定	稳定
		存储器模块	6-20	6-20	稳定	稳定
		eMMC	12-36	12-36	稳定	稳定
		固态驱动 (SSD)	12-36	12-36	稳定	稳定
	SK Hynix	NANDflash	6-10	6-10	缩短	缩短
		eMMC	8-12	8-12	稳定	稳定
被动元件	Murata	滤波器	12-16	12-16	稳定	稳定
		电感/变压器	12-20	12-20	稳定	稳定
		引线陶瓷电容	16-18	16-18	稳定	稳定
		专用电容	15-16	15-16	稳定	稳定
	TDK	滤波器	12-16	12-16	延长	上升
		电感/变压器	16-20	16-20	稳定	稳定
		表面贴装通用陶瓷电容 (车规级)	24-30	14-30	稳定	稳定

资料来源：芯八哥公众号，富昌电子，Wind，天风证券研究所

头部企业订单及库存情况：2025年1月，消费类订单增长稳定，库存较低；汽车和工业订单低迷，库存去化持续；通信订单下降；AI和新能源订单保持增长。

图 8：头部厂商 2025 年 1 月订单及库存

公司	1月订单	1月库存	2月订单预测	2月库存预测
Intel	稳定	低	稳定	低
AMD	上升	低	上升	低
NVIDIA	上升	无	上升	无
三星	上升	低	上升	下降
TI	下降	较高	下降	下降
ST	下降	一般	下降	一般
ADI	下降	一般	下降	一般
Qualcomm	上升	低	上升	低
Broadcom	稳定	低	稳定	一般
NXP	下降	一般	下降	低
Infineon	下降	一般	下降	较低
Renesas	下降	低	下降	一般
Onsemi	下降	低	下降	低
Microchip	下降	一般	下降	一般
Micron	上升	低	上升	低
SK Hynix	上升	低	上升	低
Murata	上升	低	上升	低
MTK	上升	低	上升	低

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

4. 2025 年 1 月产业链各环节景气度：

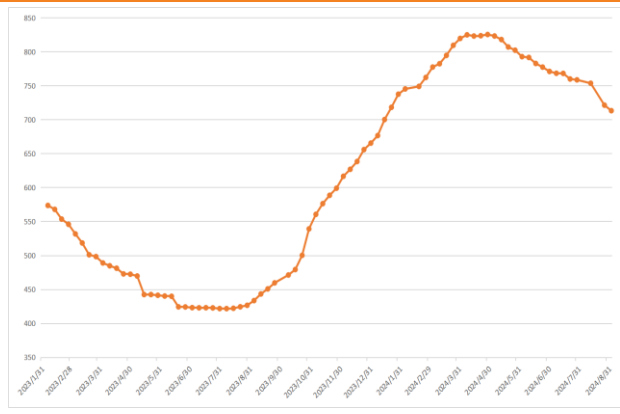
4.1. 设计：库存去化效益显现，需求复苏有望带动基本面持续向好

4.1.1. 存储：本周存储现货市场多数价格“下探寻底”，嵌入式产品结构分化行情延续

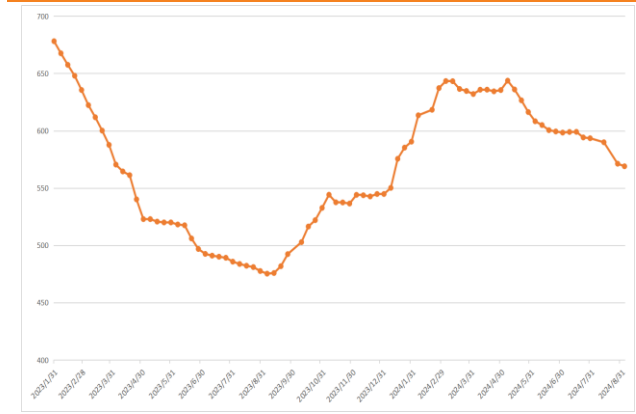
根据闪存市场公众号对存储行情的周度(截至 2025.2.11)评述，存储现货市场整体成交较为一般，原本短暂平静的渠道市场受部分存储厂商杀价行为影响被打破，渠道 SSD 和内存条多数价格下挫。嵌入式市场整体供应偏多，除低容量 eMMC 以外，大容量嵌入式和 LPDDR 4X 产品价格普遍向下调整。近期，部分手机厂商掀起一波年货节促销战。上月月底，华为宣布 Pura 70 全系、Mate X5 等多款手机开启降价，Pura 70 Ultra 最高优惠 2000 元，Mate X5 最高优惠 2500 元；而苹果天猫官方旗舰店于 1 月 4 日也官宣 iPhone 16 全系列直降 800 元，叠加 200 元惊喜券后，最高优惠 1000 元。而目前正当季节性淡季时，个别的促销举动难以改变一季度需求弱势。根据 CFM 近期发布的《2024 全球存储市场总结与 2025 展望》显示，2025 年 Q1 手机领域的存储价格将全面下调，Mobile NAND 平均售价跌幅将超过 10%。嵌入式产品市场表现分化明显。随着存储原厂逐渐推进制程迭代和产品升级，部分成熟制程资源逐渐停产，导致供应持续紧俏，在料号相对单一、资源涨价的传导效应作用下，相对应的嵌入式成品价格涨势明显。而 64GB 以上的大容量嵌入式产品相对来说可选的资源 and 方案较多，目前资源端仍处于供应过剩状态。值得注意的是，近三个月来，32GB eMMC 价格涨幅高达 27%，与 64GB eMMC 价格差距逐渐缩小。不过，嵌入式产品往往需要经过长时间产品适配和验证，短时间内，部分终端采购需求难以从 32GB eMMC 转移到 64GB eMMC，趋紧的供需关系还将继续推涨 32GB eMMC 价格，尤其是 32GB 市场低点价格涨势较快。长期来看，低成本 AI 出现将助推更多的企业和个人开展更多 AI 应用，推动 AI 应用加速普及和 AI 需求大爆发，届时的存算力需求也将再上新台阶。DeepSeek 的开源策略无疑加剧了云服务商之间的竞争。然而，观察北美几家主要云厂商所公布的资本支出计划，不难发现，它们依旧不遗余力的斥巨资投放至人工智能领域。据 CFM 闪存市场统计，微软、谷歌、亚马逊、Meta 今年资本支出累计总额将超 3200 亿美元，同比去年增长逾 40%。而随着 Deepseek 这种靠强大算法创新，而非通过大量 AI 芯片进行算力堆叠出来的大语言模型持续发展，明后年云服务商资本支出是否能保持高速增长将成为未知数。

图 9： NAND 价格指数

图 10： DRAM 价格指数



资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所



资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

上游资源方面，春节假期结束后，FlashWafer 和 DDR 颗粒整体变化不大，报价基本维持年前水平。

图 9：Flash Wafer 最新报价（当前价为美元）(02/11)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
1Tb QLC	4.50	4.50	0.00% 0
1Tb TLC	5.40	5.40	0.00% 0
512Gb TLC	2.95	2.95	0.00% 0
256Gb TLC	1.45	1.45	0.00% 0

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

图 10：DDR 最新报价（当前价为美元）(02/11)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 16Gb 3200	2.10	2.10	0.00% 0
DDR4 16Gb eTT	1.73	1.73	0.00% 0
DDR4 8Gb 3200	1.10	1.10	0.00% 0
DDR4 8Gb eTT	0.88	0.88	0.00% 0
DDR4 4Gb eTT	0.55	0.55	0.00% 0

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

渠道市场方面，部分渠道厂商交货周期延长，部分年前成交订单仍在生产进程中。从需求上来看，客户年前备货谨慎，基本遵循“按需拿货”原则，随着节后库存消耗到一定水平，近期渠道客户询单也有所增加，渠道存储价格有小幅上涨的迹象出现，但由于涨幅非常小，本周渠道 SSD 和内存条价格基本维持持平。

行业市场方面，上月月底，国内新一轮政策补贴已在全国范围内启动，其中 PC 最高补贴比例达 20%，行业存储厂商的部分 PC 客户在国补刺激下销售有所提升。不过由于目前正处于消费电子传统淡季，国补对市场需求的拉动作用仍然有限。也正因受需求步入淡季影响，宏碁、华硕等台湾 PC OEM 的 1 月营收环比下滑幅度均在 20-40%不等，财务压力剧增。因此，本周行业 SSD 价格普遍下调，内存条价格不变。

图 11：渠道市场 SSD 最新报价（当前价为美元）(02/11)

图 12：行业市场 SSD 最新报价（当前价为美元）(02/11)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
SSD 120GB SATA 3	5.70	5.70	0.00% 0
SSD 240GB SATA 3	8.80	8.80	0.00% 0
SSD 480GB SATA 3	17.50	17.50	0.00% 0
SSD 256GB PCIe 3.0	11.50	11.50	0.00% 0
SSD 512GB PCIe 3.0	20.20	20.20	0.00% 0
SSD 1TB PCIe 3.0	39.00	39.00	0.00% 0
SSD 512GB PCIe 4.0	26.20	26.20	0.00% 0
SSD 1TB PCIe 4.0	42.00	42.00	0.00% 0
SSD 2TB PCIe 4.0	80.00	80.00	0.00% 0

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

图 13：渠道市场内存条最新报价（当前价为美元）（02/11）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 UDIMM 8GB 3200	7.60	7.60	0.00% 0
DDR4 UDIMM 16GB 3200	16.00	16.00	0.00% 0
DDR4 UDIMM 32GB 3200	36.00	36.00	0.00% 0

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

产品名称	本周价	上周价	涨跌
SSD 256GB SATA 3	15.00	15.20	-1.32% -0.2
SSD 512GB SATA 3	25.50	26.20	-2.67% -0.7
SSD 1T SATA 3	48.00	49.00	-2.04% -1
SSD 256GB PCIe 3.0	16.00	16.20	-1.23% -0.2
SSD 512GB PCIe 3.0	28.00	28.50	-1.75% -0.5
SSD 1TB PCIe 3.0	49.50	49.50	0.00% 0
SSD 512GB PCIe 4.0	30.00	31.00	-3.23% -1
SSD 1TB PCIe 4.0	52.00	53.00	-1.89% -1
SSD 2TB PCIe 4.0	96.00	102.00	-5.88% -6

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

图 14：行业市场内存条最新报价（当前价为美元）（02/11）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 SODIMM 4GB 3200	8.90	8.90	0.00% 0
DDR4 SODIMM 8GB 3200	12.50	12.50	0.00% 0
DDR4 SODIMM 16GB 3200	22.50	22.50	0.00% 0

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

嵌入式市场方面，去年下半年以来，DRAM 原厂相继减产 LPDDR4X，NAND 原厂西部数据近期也宣布减产，期盼通过控制供应来减缓手机存储终端 ASP 下滑幅度，不过整体供应仍然过剩；虽目前多数手机终端厂商库存水位维持在正常水平，但对后市的看法仍然看跌，因此，备货态度较为谨慎；加之一季度通常为传统淡季，整体上看市场需求仍维持平淡。因此，本周嵌入式价格维持年前水平。

图 15：eMMC 最新报价（当前价为美元）（02/11）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
eMMC 8GB 5.1	1.80	1.80	0.00% 0
eMMC 16GB 5.1	2.40	2.40	0.00% 0
eMMC 32GB 5.1	2.60	2.60	0.00% 0
eMMC 64GB 5.1	3.50	3.50	0.00% 0
eMMC 128GB 5.1	6.40	6.40	0.00% 0
eMMC 256GB 5.1	13.20	13.20	0.00% 0

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

图 17：UFS 最新报价（当前价为美元）（02/11）

图 16：LPDDR 最新报价（当前价为美元）（02/11）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
LPDDR4X 96Gb	20.00	20.00	0.00% 0
LPDDR4X 64Gb	12.50	12.50	0.00% 0
LPDDR4X 48Gb	9.00	9.00	0.00% 0
LPDDR4X 32Gb	5.40	5.40	0.00% 0
LPDDR4X 16Gb	2.40	2.40	0.00% 0
LPDDR4X 8Gb	1.70	1.70	0.00% 0

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

图 18：uMCP 最新报价（当前价为美元）（02/11）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
UFS 2.2 64Gb	4.60	4.60	0.00% 0
UFS 2.2 128Gb	7.80	7.80	0.00% 0
UFS 2.2 256Gb	15.50	15.50	0.00% 0
UFS 2.2 512Gb	30.00	30.00	0.00% 0

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

产品名称	本周价	上周价	涨跌
uMCP (LPDDR4X+UF S2.2) 4GB+128GB	14.50	14.50	0.00% 0
uMCP (LPDDR4X+UF S2.2) 6GB+128GB	18.30	18.30	0.00% 0
uMCP (LPDDR4X+UF S2.2) 8GB+128GB	23.00	23.00	0.00% 0
uMCP (LPDDR4X+UF S2.2) 4GB+256GB	30.00	30.00	0.00% 0

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

图 19：eMCP 最新报价（当前价为美元）(02/11)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
eMCP (eMMC+LPDDR4X) 64GB+32Gb	10.50	10.50	0.00% 0
eMCP (eMMC+LPDDR4X) 128GB+32Gb	13.50	13.50	0.00% 0
eMCP (eMMC+LPDDR4X) 128GB+48Gb	17.50	17.50	0.00% 0

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

NVIDIA H200 发布催化 HBM 发展：英伟达发布全新 H200 GPU 及更新后的 GH200 产品线。相比 H100，H200 首次搭载 HBM3e，运行大模型的综合性能提升 60%-90%。而新一代的 GH200 依旧采用 CPU+GPU 架构，也将为下一代 AI 超级计算机提供动力。HBM3E 是市场上最先进的高带宽内存(HBM)产品，HBM 即为高带宽内存(High Bandwidth Memory)，是一种基于 3D 堆栈工艺的高性能 DRAM，通过增加带宽，扩展内存容量，让更大的模型，更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟、降低功耗。HBM 的高带宽相当于把通道拓宽，让数据可以快速流通。因此面对 AI 大模型千亿、万亿级别的参数，服务器中负责计算的 GPU 几乎必须搭载 HBM。英伟达创始人黄仁勋也曾表示，计算性能扩展的最大弱点是内存带宽，而 HBM 的应用打破了内存带宽及功耗瓶颈。在处理 Meta 的大语言模型 Llama2 (700 亿参数) 时，H200 的推理速度比 H100 提高了 2 倍，处理高性能计算的应用程序上有 20% 以上的提升，采用 HBM3e，完成了 1.4 倍内存带宽和 1.8 倍内存容量的升级。

HBM 的制程发展：目前市场上最新 HBM3E，即第 5 代 HBM，正搭载在英伟达的产品中。随着 AI 相关需求的增加，第六代高带宽存储器 HBM4 最早将于 2026 年开始量产。据韩媒报道，SK 海力士已开始招聘 CPU 和 GPU 等逻辑半导体设计人员。SK 海力士希望 HBM4 堆栈直接放置在 GPU 上，从而将存储器和逻辑半导体集成在同一芯片上。这不仅会改变逻辑和存储设备通常互连的方式，还会改变它们的制造方式。如果 SK 海力士成功，这可能会在很大程度上改变部分半导体代工的运作方式。

图 20：HBM 制程发展

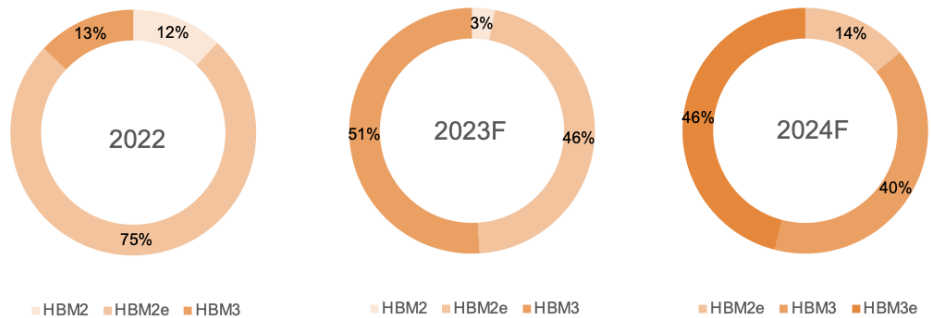
🏠 : Early sample to NVIDIA C/S MP

	Brand	Speed (Gbps)	Tech Nodes	2022				2023				2024				2025				2026			
				1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26
HBM2e	SUMSUMG	3.2-3.6	1Y 16Gb	8/16GB												EOL Time: Not Fixed Yet							
	SK hynix	3.6	1Y 16Gb	8/16GB																			
	Micron	3.2-3.6	1Z 16Gb	16GB				EOL															
HBM3	SUMSUMG	6.4	1Z 16Gb					16GB															
	SK hynix	5.6-6	1Z 16Gb	16GB				24GB															
HBM3e	SUMSUMG	8	1alpha 24Gb									24GB				36GB							
	SK hynix	8	1beta 24Gb													36GB							
	Micron	8	1beta 24Gb													36GB							
HBM4		TBD	TBD	Full spec may be released in 3H24-3Q25; C/S in 2026																			

资料来源: TrendForce, MTS2024 存储产业趋势研讨会, 天风证券研究所

HBM 迭代进程: 2024 年 HBM2、HBM2e 和 3e 的市场份额发生了比较明显的改变。2023 上半年主流还是 HBM2e, 但是因为 H100 的问世, 2024 下半年 HBM3 就成为了市场主流。因为它堆叠的层数更高, 所以平均单价一定要比现在再高 20%-30%以上, 所以它对产值的贡献会更明显。

图 21: HBM 比重转进 (依位元计算)



资料来源: TrendForce, MTS2024 存储产业趋势研讨会, 天风证券研究所

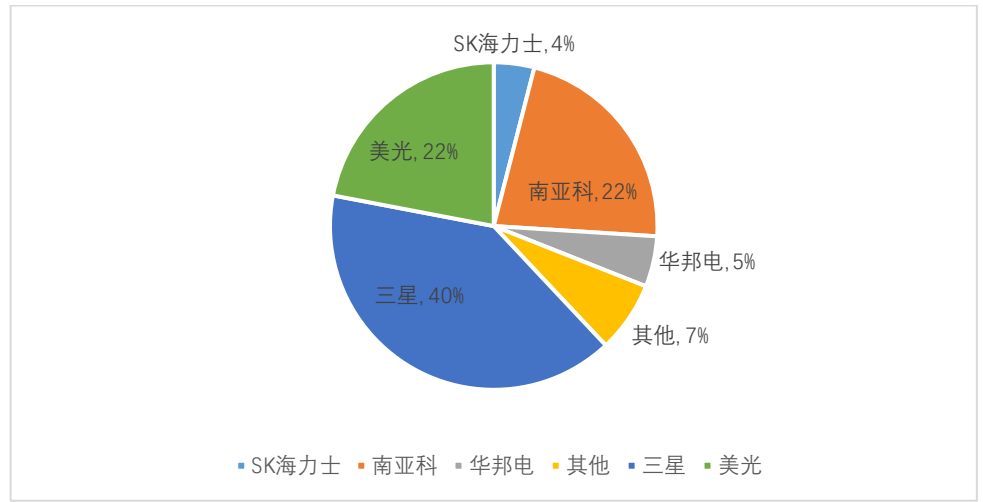
值得关注的是, 近期三星、SK 海力士正加大对 HBM、DDR5 等高端产品投入, 计划逐步退出 DDR3 等市场。作为 DDR3 主要供应商, 产能调整对于终端供应及价格影响较大。

表 2: 头部存储厂商减产 DDR3

国家/地区	厂商	DDR3 减产情况
韩国	三星	拟 2024Q2 底停产 DDR3
韩国	SK 海力士	将无锡厂 DDR3 产能转移至其他产品, 或不再提供 DDR3
美国	美光	为扩大 DDR5、HBM 产能, 大幅减少 DDR3 供应量
中国台湾	南亚科	产能开始大幅转向 DDR5, DDR3 仅接受客户代工订单

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

图 22: 三星等厂商占 DDR3 市场主要份额



资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

图 23: DDR3 价格走势一览 (元)



资料来源：Wind，芯八哥公众号，天风证券研究所

长远看，随着三星、SK 海力士及美光等头部厂商加速扩产 HBM 等高端应用品类，国产厂商在 DDR3 等中低端市场替代潜力较大。从量产进展看，包括兆易创新及北京君正等均实现了规模出货，在 DDR3 产品性能比肩海外厂商，但料号数量方面仍有差距。

表 3: 部分国产 DDR3 量产厂商情况

厂商	量产产品	具体情况
兆易创新	DDR3L 2Gb、4Gb 等	2022 年推出的 DDR3L GDPxxxL M 系列产品，DDR3 在 2023 年规模量产入市，已基本覆盖网通、TV 等应用领域及主流客户群
北京君正	DDR3 等	DDR3 在 DRAM 产品中的占比约在 50% 左右，2024Q2 订单需求较大
江波龙	DDR3L 等	2020 年符合 JEDEC 标准 DDR3 产品量产，在海思、中兴微等多家平台完成主控端认证
东芯股份	DDR3 等	DDR3 产品具备高宽带、低延时的特点，已经在通讯设备、移动终端等领域成熟应用

资料来源：各公司财报，芯八哥公众号，天风证券研究所

CES2024-SK 海力士着重强调存储在 AI 时代发挥关键作用：SK 海力士在拉斯维加斯举行的 CES2024 期间举行了题为“存储，人工智能的力量”的新闻发布会，SK 海力士社长兼

CEO 郭鲁正在会上阐述了 SK 海力士在人工智能时代的愿景。发布会上，郭社长表示，随着生成人工智能的普及，存储的重要性将进一步提高。他还表示，SK 海力士正在向 ICT 行业提供来自世界最佳技术的产品，引领“以存储为中心的人工智能无处不在”。郭社长在新闻发布会上提到：ICT 行业在 PC、移动和现在基于云的人工智能时代发生了较大的发展。在整个过程中，各种类型和大量的数据都在生成和传播。现在，我们进入了一个建立在所有数据基础上的 AGI 新时代。因此，新时代将朝着 AGI 不断生成数据并重复学习和进化的市场迈进。在 AGI 时代，存储将在处理数据方面发挥关键作用。从计算系统的角度来看，存储的作用甚至更为关键。以前，系统基本上是数据流从 CPU 到内存，然后以顺序的方式返回 CPU 的迭代，但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。现在，人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器，以加速大规模数据处理。这意味着人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。人工智能时代的存储方向应该是以最快的速度、最有效的方式和更大的容量处理数据。这与过去一个世纪的存储开发一致，后者提高了密度、速度和带宽。

图 24：24Q2-24Q3 NAND FLASH 产品合约价涨跌幅预测

	2024Q3	2024Q4E
eMMC UFS	mostly flat	down 8~13%
Enterprise SSD	up 15~20%	up 0~5%
Client SSD	up 3~8%	down 5~10%
3D NAND Wafers (TLC & QLC)	down 3~8%	down 10~15%
Total NAND Flash	up 5~10%	down 3~8%

图 25：24Q3-24Q4 DRAM 产品合约价涨跌幅预测

	2024Q3	2024Q4F
PC DRAM	DDR4: up 8~13% DDR5: up 8~13% Blended: up 8~13%	DDR4: mostly flat DDR5: mostly flat Blended: mostly flat
Server DRAM	DDR4: up 8~13% DDR5: up 13~18% Blended: up 13~18%	DDR4: mostly flat DDR5: up 3~8% Blended: up 0~5%
Mobile DRAM	mostly flat	LPDDR4X: down 5~10% LPDDR5X: mostly flat
Graphics DRAM	up 3~8%	mostly flat
Consumer DRAM	DDR3: mostly flat DDR4: up 3~8%	DDR3: down 0~5% DDR4: mostly flat
Total DRAM	Conventional DRAM: up 8~13% HBM Blended: up 10~15% (HBM Penetration:6%)	Conventional DRAM: up 0~5% HBM Blended: up 8~13% (HBM Penetration:7%)

资料来源：集邦存储市场公众号，天风证券研究所

资料来源：集邦存储市场公众号，天风证券研究所

4.2. 代工：中国成熟制程厂商或掀起新一轮价格战，AI 需求增长下部分厂商加速布局

2025 年 1 月，AI 成为晶圆代工厂商主要增长市场，汽车和工业订单需求仍较弱，

图 26：主要晶圆代工厂动态

厂商	25.1 产能利用率	25.1 动态	25.2 订单预测
台积电	95%-100%	3nm、5nm 和 CoWoS 工艺涨价 5%-20%，2024 年 AI 相关营收占比约 15%，超百亿美元，2024 年底美国亚利桑那州首家 4nm 工厂量产，日本晶圆厂同时实现量产	上升
三星	80%-90%	NVIDIA 和高通部分 2nm 订单将从台积电转至公司，削减 2025 年晶圆代工投资超 50%	稳定
联电	70%	各终端需求逐渐稳定，库存明显下降，预计 2025 年营收同比增长	稳定
中芯国际	90%-100%	2025 年芯片增量会优于去年，汽车和工业需求较弱	上升
格芯	65%-75%	与 ST 合作的法国 Crolles 的 12 英寸晶圆厂项目陷入停滞，拟 5.75 亿美元扩建纽约晶圆厂	稳定
世界先进	65%-70%	预计今年半导体业景气温和成长	下降
力积电	60%-70%	积极转型开发中介层等 AI 利基型元件	下降
华虹	>100%	12 英寸平台如 BCD、CIS 等需求持续强劲	上升

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

2025 年 1 月，头部厂商订单增长明显，预计今年 AI 相关封测订单增长强劲。

图 27：主要封测厂商动态

厂商	25.1 产能利用率	25.1 动态	25.2 订单预测
日月光	75%-85%	预计今年先进封装占整体比重达10%-15%	上升
台积电	100%	短期内将扩充八座CoWoS厂	上升
长电科技	70%-85%	海外业务收入增长稳定	上升
通富微电	80%-90%	半导体行业逐步进入周期上行阶段	上升
华天科技	80%-90%	订单增加，产能利用率提高	上升
京元电	70%-80%	2025年积极扩大AI和HPC产能	上升
中小封测厂	60%-70%	订单稳定，价格相对低迷	稳定

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

AI 需求全面提升，带动先进封装需求提升，台积电启动 CoWoS 大扩产计划。2024 年一季度以来，市场对 AI 服务器的需求不断增长，加上 Nvidia 的强劲财报，造成台积电的 CoWoS 封装成为热门话题。据悉，Nvidia、博通、谷歌、亚马逊、NEC、AMD、赛灵思、Habana 等公司已广泛采用 CoWoS 技术。台积电董事长刘德音在 2024 年股东大会上表示，最近因为 AI 需求增加，有很多订单来到台积电，且都需要先进封装，这个需求远大于现在的产能，迫使公司要急遽增加先进封装产能。

Chiplet/先进封装技术有望带动封测产业价值量提升，先进封装未来市场空间广阔。据 Yole 分析，先进封装 (AP) 收入预计将从 2022 年的 443 亿美元增长到 2028 年的 786 亿美元，年复合增长率为 10%。在封装领域，2.5D、3D Chiplet 中高速互联封装连接及 TSV 等提升封装价值量，我们预测有望较传统封装提升双倍以上价值量，带来较高产业弹性。

部分封测厂产能利用率回到较高水平，金属价格上涨或带动封测涨价。一季度受到华为手机对国产芯片供应链的拉动，以及 AI 等的需求增长，部分封测厂（如华天/甬矽等）产能利用率回到较高水位，淡季不淡，超出市场预期。近期金属价格上涨，封测成本端预计有所提升，加之下半年产业链进入传统旺季，我们预计封测价格有提升的动力，建议关注产业链相关公司的投资机遇。

4.3. 设备材料零部件：1 月，可统计中标设备数量 22 台，无可统计招标设备

2025 年 1 月，半导体设备需求相对稳定，材料订单相对低迷。

图 28：半导体设备及硅晶圆头部企业情况

类型	企业	25.1月订单	25.1月库存	25.2月订单预测
设备	ASML	上升	低	稳定
	AMAT	稳定	低	上升
	泛林	上升	低	上升
	TEL	稳定	低	上升
	科磊	上升	低	稳定
	北方华创	上升	低	上升
	中微公司	上升	低	上升
硅晶圆	信越化学	下降	一般	稳定
	Sumco (胜高)	下降	一般	下降
	环球晶圆	下降	较高	下降
	台胜科技	下降	较高	下降
	合晶科技	下降	较高	下降
	沪硅产业	上升	一般	稳定

资料来源：Wind，天风证券研究所

4.3.1. 设备及零部件中标情况：1 月可统计中标设备数量 22 台，同比-18.5%

2025 年 1 月可统计中标设备数量共计 22 台，同比-18.5%。薄膜沉积设备 2 台，溅射设备 1 台，辅助设备 1 台，抛光设备 1 台，检测设备 2 台，刻蚀设备 7 台，其他设备 8 台。

图 29：2025 年 1 月部分国内企业可统计中标情况（台）

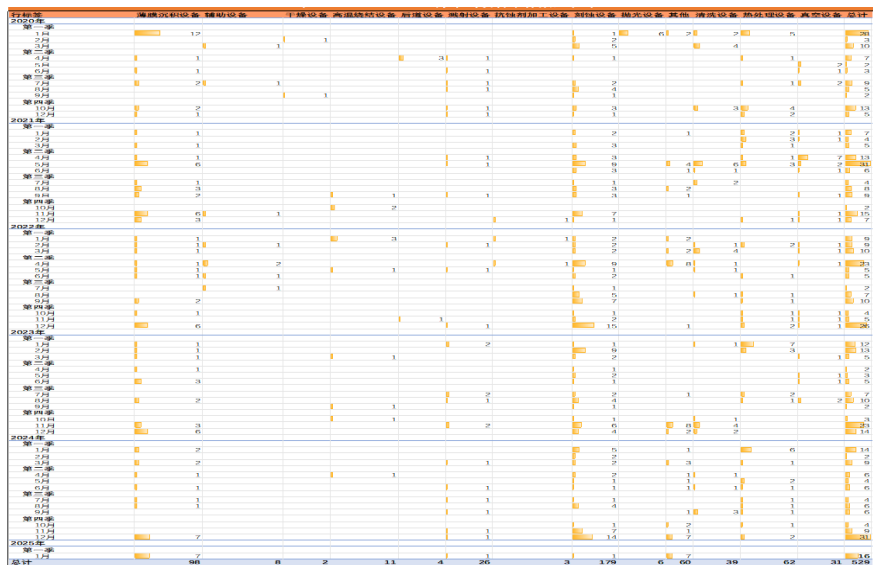
表3：2025年1月设备中标情况统计

行标签	刻蚀设备	其他	薄膜沉积设备	溅射设备	辅助设备	抛光设备	检测设备	总计
北方华创	7	7		1	1			16
拓荆科技				1				1
正帆科技						1		1
华海清科							1	1
武汉精测		1						2
总计	7	8	2	1	1	1	2	22

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

2025年1月，北方华创可统计中标设备16台，同比+14%，环比-50%，包括1台薄膜沉积设备，1台溅射设备，7台刻蚀设备，7台其他。

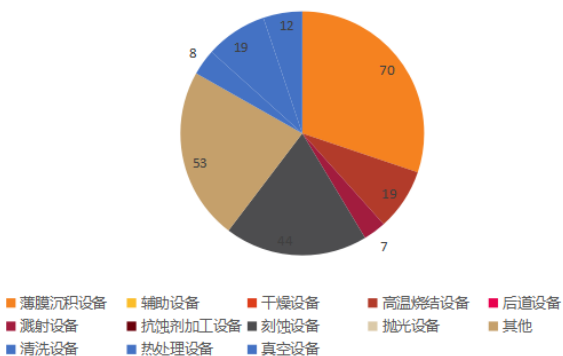
图 30：2020-2025.1 北方华创可统计中标情况（台）



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

图 31：2023 年北方华创各主要设备类型中标分布情况（台）

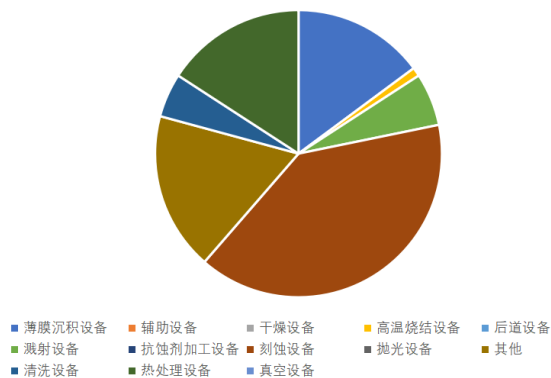
北方华创2023年各主要设备类型中标分布情况



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

图 32：2024 年 1-12 月北方华创各主要设备类型中标分布情况（台）

北方华创2024年各主要设备类型中标分布情况



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

2025年1月，国内半导体零部件可统计中标共21项，同比+50%。主要为电气类16项，为北方华创、英杰电气中标。

图 33：2011-2025.1 国内半导体设备零部件可统计中标情况（台）

2012年					1	1
2015年					3	3
2017年					7	9
2018年					5	5
2019年	2				7	9
2020年		1			3	4
2021年	5				8	13
2022年	3				3	3
2023年	2	3			5	10
2024年	5	4	10		1	19
2025年					1	1
第一季度					1	1
MKS、Inficon					1	1
2018年					1	1
MKS、VAT					1	1
2020年					1	1
Newport	2	100	29		1	132
2022年	1	8			1	10
2023年		72	19			91
2024年	1	20	9			30
2025年			1			1
第一季度			1			1
Pfeiffer					164	164
2015年					5	5
2016年					5	5
2017年					4	4
2018年					9	9
2019年					7	7
2020年					21	21
2021年					19	19
2022年					26	26
2023年					44	44
2024年					25	25
Pfeiffer、VAT					2	2
2020年					2	2
VAT	3				33	36
2011年					1	1
2017年					1	1
2018年					3	3
2019年					2	2
2020年					1	1
2021年					1	1
2022年					5	5
2023年					9	9
2024年	3				10	13
蔡司	5	252	1		3	261
2017年		2				2
2019年	1	3				4
2020年		6				6
2021年		4				4
2022年		37			2	39
2023年		94				94
2024年	4	99	1		1	105
2025年		7				7
第一季度		7				7
(空白)						
总计	52	363	5	43	1	391
						855

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

4.3.2. 设备招标情况：无可统计招标设备

2025年1月无可统计招标设备。

2025年1月，华虹宏力无可统计招标设备。

2020-2025.1，公司可统计招标设备共 3592 台，包括 246 台薄膜沉积设备、395 台辅助设备、56 台光刻设备、69 台后道设备、305 台检测设备、2 台溅射设备、34 台抗蚀剂加工设备、152 台刻蚀设备、33 台离子注入设备、45 台抛光设备、1523 台其他设备、140 台清洗设备、388 台热处理设备、204 台真空设备。

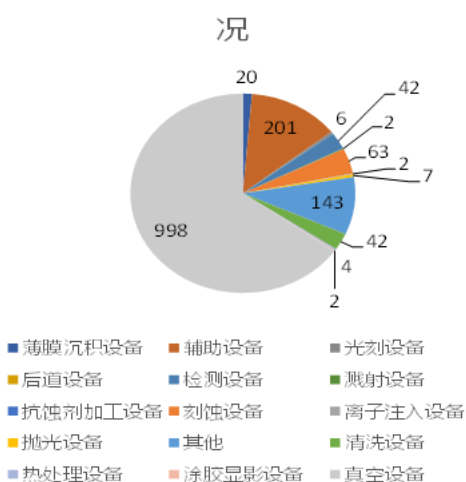
图 35：2020-2025.1 华虹宏力可统计招标情况（台）

年份	薄膜沉积设备	辅助设备	光刻设备	后道设备	检测设备	抗蚀剂加工设备	离子注入设备	抛光设备	清洗设备	热处理设备	真空设备	其他	总计
2020年	122	90	20	5	147	6	56	20	20	321	76	52	193
1月													8
2月		4	2		43		2		270	10	22		327
3月	20	52	10		38		19	13	11	19	25	19	147
4月	56	32	3				2		3	30			172
5月	4						6				2		12
6月	7				18		4	2			4		35
7月	5				10		6	1	2		3	5	32
8月	4			3	1		1				2	1	12
9月	7		1	1	11		2	2	2		7	1	36
10月		2			3								5
11月	14		1	1	27		6		1	1	18		66
12月	5				2		4	1	1		5	3	21
2021年	101	240	10	26	16	2	5	62	12	17	173	38	248
1月	1	217			1		2			1		126	248
2月		2											3
3月					2		3			1			6
4月					3		3						10
5月					2	1							3
6月					1	5	1						7
7月	5	21	1	4	6				1	170	3		211
8月	1			4	2								6
9月	1								1	1			3
10月	1												2
11月							2						2
12月		92		7	10		5	53	11	15		26	113
2022年	13	52	5	10	106	2	20	1	1	11	9	57	282
1月		3	2	3	75		1				4		88
2月		1	6										7
3月		4	2	1	3	6			1	1	2	3	31
4月		1	3		1		1				1	34	38
5月		2	36									6	48
6月													0
7月		2					2						4
8月		1			2		2						5
9月		1			4					8	2	5	20
10月					1								1
11月					1								5
12月		1	3	1	4	18						7	38
2023年	10	13	21	28	35		21	14	7	17	16	31	11
1月		5	1		1		3			1	1	4	16
2月		1	3							13			28
3月		1	6										6
4月													1
5月							6						6
6月													0
7月		4	3	21	27	31		21	2		6	1	20
8月													9
9月					1	1				2			4
10月					1	1						13	14
11月													3
12月						1				1			1
2024年					1					1			3
1月													0
2月													0
3月													0
4月					1								2
5月											1		1
6月													0
7月													0
8月													0
9月													0
10月													0
11月													0
12月													0

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

图 36：2023 年华虹宏力各主要设备类型中标分布情况（台）

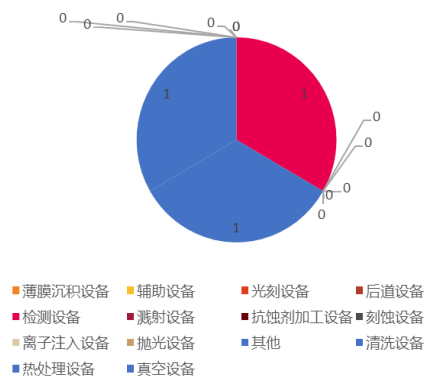
2023年主要设备类型招标分布情况



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

图 37：2024 年 1-12 月华虹宏力各主要设备类型中标分布情况（台）

华虹华力2024年主要设备类型招标分布



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

4.4. 分销商：2025 年分销市场订单预期乐观，关注日系分销商加大在中国半导体市场采购和布局

2025 年分销市场订单预期乐观，关注日系分销商加大在中国半导体市场采购和布局。

图 38：主要元器件分销商最新动态

厂商	24年12月动态
Restar	增加对中国大陆产半导体采购
安富利	中国市场订单回升较快
大联大	2025年AI订单持续增长
文晔科技	2025年汽车和AI订单会持续上升,工业有改善,看好光通信发展
RYOSAN	积极增加在中国半导体市场布局
中电港	今年公司模拟营收和价格都在下降
香农芯创	SK海力士产品订单增长稳定
英唐智控	DDIC已批量交付且订单稳定,TDDI产品已完成验证
力源信息	看好2025年汽车订单增长
好上好	2025年积极布局汽车、AI和功率器件、存储等市场
雅创电子	2025年将持续深耕汽车电子领域

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5. 终端应用：看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势

5.1. 消费电子：预计 2025 年折叠屏手机市场增速放缓，关注海外农业无人机市场增长机会。

2025 年 1 月，手机和 PC 订单增长相对稳定，看好农业级无人机增长。预计 2025 年折叠屏手机市场增速放缓，关注海外农业无人机市场增长机会。

表 4：消费电子厂商最新动态

类别	企业	2025 年 1 月动态
智能手机	苹果	2024Q4iPhone 收入低于预期，中国市场竞争激烈 2024 年中国
	三星	计划 2025 年减少折叠屏手机出货;三折屏手机即将量产
	华为	2025 年折叠屏机型或减少
	VIVO	2024 年中国智能手机市场份额第一，达 17.6%
	小米	2024 年智能手机出货量 1.69 亿部
	传音	将建深圳智能终端产业生态全球总部项目
PC	联想	将在沙特开设 PC 工厂 2026 年运营，收购以色列存储公司 Infinidat;预计 AIPC 未来三年普及率达 50%
	华硕	2024 年 PC 出货 1739 万台，同比增长 1.3%
	宏碁	2024 年 PC 出货 1692.7 万台，同比增长 6.5%
	戴尔	PC 市场表现仍然低迷
VR/AR	Meta	2025 年持续保持 AI 眼镜研发和投入
	苹果	Vision Pro 订单增长乏力
	HTC	2.5 亿美元将 XR 部门部分出售给谷歌
	谷歌	推出 Android XR 系统
无人机	大疆	无人机在工业领域应用快速增长
无人机	极飞科技	预计今年公司将实现盈利，海外市场份额有约 100%增长

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5.2. 新能源汽车：汽车头部厂商格局分化，海外市场增长相对低迷。

汽车头部厂商格局分化，海外市场增长相对低迷。

表 5：新能源汽车厂商最新动态

厂商	2025 年 1 月动态
比亚迪	2024 年销量达 427.21 万辆，连续三个月单月销量超 50 万辆
特斯拉	预计 2025 年公司汽车销量将增长 20%-30%

本田	或与日产合并；计划到 2030 年将混动车销量翻番
大众	计划 2030 年前在德国裁员约 3.5 万人；因产能利用率低，计划关闭南京工厂
宝马	与中国厂商在大模型生成式 AI、智能语音交互等展开合作
奔驰	最新 L3 级自动驾驶在德国获批
丰田	投资至少 16 亿美元升级改造泰国工厂；拟向美国肯塔基工厂投资 10 亿美元生产电动 SUV；bZ4X 2025 年售价将降低 6000 美元
福特	欧洲市场电车业务订单恶化
Stellantis	和宁德时代将在西班牙建电池厂
通用	拟斥资逾 50 亿美元重组中国业务；计划调整自动驾驶战略；与充电设备运营商 ChargePoint 合作建充电基础设施
现代	解散半导体部门，放弃自研 5nm 芯片
广汽埃安	2024 累计销量约为 41.21 万辆，同比有所下降
吉利	2024 年 38 万辆海外销量目标已完成 99%
奇瑞	提前完成百万辆海外销售目标，超上汽成为国内汽车出口第一
理想	预计 2025 年汽车销量达 70 万辆
长城	2024 年总销量 123.33 万辆，同比增长 0.21%；新能源车销量 32.18 万辆，同比增长 22.82%
小米	2024 年交付量超 13.5 万辆，2025 年交付目标上调 30 万辆
赛力斯	2024 年新能源汽车销量超 42 万辆，同比增长 182%
蔚来	2025 年销量目标为 46 万辆
小鹏	预计 2025 年底前实现单季盈亏平衡

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5.3. 工控：中国工控市场需求增长较快，国产替代快速提升。

2025 年 1 月，中国工控市场需求增长较快，国产替代快速提升。

表 6：工控厂商最新动态

厂商	2025 年 1 月动态
西门子	预计 2025 年公司自动化设备业务尤其在中国市场不确定性仍存
ABB	2024 年营收 329 亿美元，同比增长 2%；预计 2025 年保持增长
霍尼韦尔	2024Q4 公司未交货订单增长 11%，达创纪录 353 亿美元；预计 2025 年营收同比增长 2%-5%
雷赛智能	2024Q4 以来公司订单呈现较快复苏态势
汇川技术	工程机械行业电动化需求快速增长
施耐德电气	数据中心和电气化订单增长较快
麦格米特	公司已具备海外全流程生产供应能力
埃斯顿	汽车及汽车零部件行业国产替代进程加快
中控技术	加大在“AI+机器人”领域的投入和布局
华中数控	新能源动力电池智能装备订单持续释放
禾川科技	光伏行业产能饱和，扩产需求下降

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5.4. 光伏：受光伏产业链价格持续低位影响，头部厂商订单增长低迷。

2025 年 1 月，受光伏产业链价格持续低位影响，头部厂商订单增长低迷。

表 7：光伏厂商最新动态

厂商	2025 年 1 月动态
隆基绿能	1 月是光伏市场需求淡季，组件价格基本持稳

天合光能	预计 2025 年全球光伏组件市场需求超 660GW，中东、拉美、亚太等新兴市场增速尤为显著
通威股份	近期市场观望情绪较强
晶科能源	2025 年中国市场预计维持稳定增长;对组件价格回归理性保持乐观
晶澳科技	2025 年预计亚非拉等新兴国家市场增速较好。
阿特斯	预计 2025 年组件出货量将达到 30 至 35GW
东方日升	预计 2024 年亏损 27 亿元-35 亿元
爱旭股份	受产业链价格持续低位影响，经营亏损幅度环比或未有改善
横店东磁	拟投约 22.43 亿建光伏项目
钧达股份	2024 年公司扣非归母净利润亏损 10-12 亿元，预计 2025 年市场回暖

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5.5. 储能：储能行业订单增长稳定，低价竞争下部分企业营收波动明显。

2025 年 1 月，储能行业订单增长稳定，低价竞争下部分企业营收波动明显。

表 8：储能厂商最新动态

厂商	2025 年 1 月动态
阳光电源	储能订单增长较快
Fluence	2024Q4 公司净亏损同比扩大 123.09%
特斯拉	上海储能超级工厂投产
阿特斯	预计 2025 年储能出货量达 11-13GWh
宁德时代	获得 Masdar 史上最大储能订单 19GWh
上能电气	印度、中东市场光储需求快速增长
盛弘股份	储能订单增长显著
亿纬锂能	加速转型储能市场
派能科技	储能产品销售价格承压，导致营业收入下滑

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5.6. 服务器：中国 AI 新创 DeepSeek 增长强劲，全球 AI 产业迎来变革。

2025 年 1 月，中国 AI 新创 DeepSeek 增长强劲，全球 AI 产业迎来变革。

表 9：服务器厂商最新动态

厂商	2025 年 1 月动态
DeepSeek	AI 模型增长强劲，市场快速扩张
微软	成立新 AI 开发团队;2025 年拟投资 800 亿美元打造 AI 智算中心
亚马逊	AI 资本开支或超 1000 亿美元
Meta	Meta AI 用户超数亿;2025 年资本支出在 600-650 亿美元，AI 相关是重点
谷歌	泰国数据中心两年内投运,将在泰扩大生产
腾讯云	拟投 1.5 亿美元在沙特建设首个中东数据中心
腾讯云	在印尼建设第三个数据中心
字节跳动	2025 年 AI 等资本支出将超 1500 亿元
HPE	获得超 10 亿美元 AI 服务器订单
戴尔	2025Q1 公司 AI 服务器订单需求保持强劲
华为	2025Q1 AI 服务器订单预期良好
联想	与沐曦股份联合发布基于 DeepSeek 大模型的一体机解决方案
浪潮	2025Q1 公司 AI 服务器订单预增 50%

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5.7. 通信：通信市场订单低迷延续，关注中国三大运营商 5G-A 商用对供应

链影响。

2025 年 1 月，通信市场订单低迷延续，关注中国三大运营商 5G-A 商用对供应链影响。

表 10：通信厂商最新动态

厂商	2025 年 1 月动态
AT&T	2024Q4 营收 323 亿美元，高于市场预期
Vodafone	与 3 UK 合并进展顺利
Verizon	或持续裁员
中国联通	2025H1 在 39 个重点城市主城区全面启动 5G-A 业务
中国电信	已接入 DeepSeek 模型
中国移动	5G-A 商用城市超 330 个
爱立信	北美市场订单强劲增长
中兴通讯	数据中心交换机等 AI 配套业务增长较快
思科	数据中心网络设备订单增长显著
诺基亚	与 AT&T 签署了一项多年扩展合作协议

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

6. 上周（02/17-02/21）半导体行情回顾

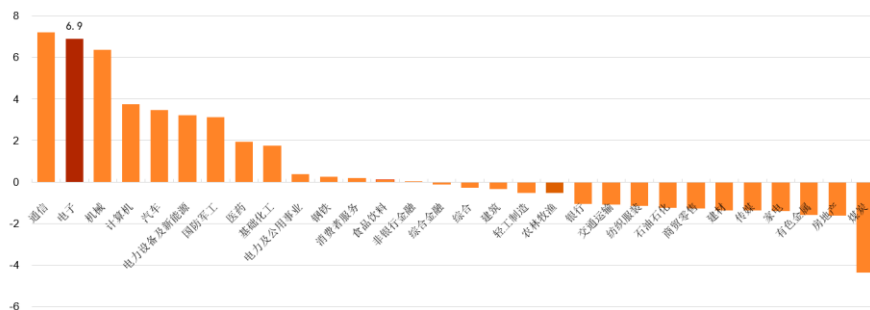
上周（02/17-02/21）半导体行情领先于主要指数。上周创业板指数上涨 2.99%，上证综指上涨 0.97%，深证综指上涨 2.25%，中小板指上涨 2.58%，万得全 A 上涨 2.06%，申万半导体行业指数上涨 8.36%。

表 11：上周半导体行情与主要指数对比

	上周涨跌幅（%）	半导体行业相对涨跌幅（%）
创业板指数	2.99	5.37
上证综合指数	0.97	7.39
深证综合指数	2.25	6.11
中小板指数	2.58	5.78
万得全 A	2.06	6.30
半导体（申万）	8.36	-

资料来源：Wind，天风证券研究所

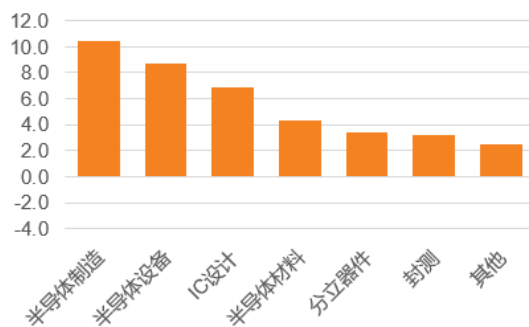
图 39：上周 A 股各行业行情对比（%）



资料来源：Wind，天风证券研究所

半导体各细分板块全部上涨，半导体制造板块涨幅最大，其他板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周上涨 3.2%，半导体材料板块上周上涨 4.4%，分立器件板块上周上涨 3.4%，IC 设计板块上周上涨 6.8%，半导体设备板块上周上涨 8.8%，半导体制造板块上周上涨 10.4%，其他板块上周上涨 2.5%。

图 40：上周子板块涨跌幅（%）



资料来源: Wind, 天风证券研究所

上周半导体板块涨幅前 10 的个股为: 国民技术、臻镭科技、润欣科技、赛微微电、伟测科技、思科瑞、大港股份、晶丰明源、天岳先进、航宇微。

上周半导体板块跌幅前 10 的个股为: 聚辰股份、普冉股份、硕中科技、新洁能、艾森股份、锴威特、芯源微、华岭股份、芯朋微、华海诚科。

表 12: 上周涨跌幅前十半导体个股

上周涨幅前 10	涨跌幅%	上周跌幅前 10	涨跌幅%
国民技术	17.08	聚辰股份	-18.87
臻镭科技	8.56	普冉股份	-15.53
润欣科技	7.84	硕中科技	-15.01
赛微微电	6.47	新洁能	-13.76
伟测科技	4.12	艾森股份	-12.67
思科瑞	3.89	锴威特	-12.63
大港股份	2.83	芯源微	-12.50
晶丰明源	2.59	华岭股份	-12.42
天岳先进	2.39	芯朋微	-12.30
航宇微	2.18	华海诚科	-12.20

资料来源: iFinD, 天风证券研究所

7. 上周 (02/17-02/21) 重点公司公告

【杨杰科技 300373.SZ】

扬州扬杰电子科技股份有限公司于 2 月 17 日发布回购股份方案公告: 基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的合理判断, 为维护股东利益、健全激励机制, 公司拟回购已发行的人民币普通股 (A 股), 用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过 58 元 / 股, 资金总额不低于 4000 万元且不超过 8000 万元, 资金来源为自有或自筹资金。按回购价格上限测算, 不同资金总额对应不同回购股份数量及占总股本比例。回购将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行, 实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至公告披露日, 未收到相关人员减持计划。同时, 本次回购存在股价超上限、重大事项影响、激励方案未通过、资金筹措不到位等风险, 公司将根据市场情况择机回购并及时披露进展, 提醒投资者注意投资风险。

8. 上周 (02/17-02/21) 半导体重点新闻

应用材料发布 SEMVision H20, 精准分类缺陷提升良率、AI 助力检测速度提升 3 倍。 2 月 19 日, 应用材料公司发布博文, 宣布推出新型芯片检测设备 SEMVision H20。在芯片制造中, 电子束成像技术对于检测微小缺陷至关重要, 然而在“埃米时代”, 区分芯片真正缺陷和误报难度剧增, 传统光学检测技术也渐显不足。SEMVision H20 采用第二代冷场发射电子显微镜技术 (CFE), 分析速度是热场发射 (TFE) 设备的三倍、第一代 CFE 技术

的两倍。CFE 技术在室温下运行，可产生更窄、电子更多的电子束，相比 TFE 技术，纳米级图像分辨率提高多达 50%，成像速度提高多达 10 倍。这不仅让设备能深入芯片底部检测，对 2 纳米以下先进逻辑芯片、高密度 DRAM 和 3D NAND 的检测意义重大，还提升了每个晶圆的覆盖率，使芯片制造商能在三分之一的时间内收集相同数量的信息。此外，SEMVision H20 运用深度学习 AI 算法，借助应用材料专有的深度学习网络，依据芯片制造商工厂的数据持续训练，能将缺陷分类到多种类型中，精准分析趋势、找出真正缺陷，进而提高芯片制造商的良率。该设备可用于所有前端工艺，其发布是芯片检测技术的重要进步，为先进制程芯片的研发和生产提供了有力支持。

日月光 2024 年斥资 2 亿美元采购 FOPLP 先进封装设备，预计 2025 年内试产。据 IT 之家 2 月 21 日消息，参考台媒《工商时报》报道，在本月 18 日的媒体活动上，OSAT 封测龙头日月光 ASE 的营运长吴田玉透露，公司在 FOPLP 面板级扇出封装领域已有长达 10 年的研发布局。目前，面板尺寸从 300×300 (mm) 扩展到了 600×600 (mm)，这一变化可使日月光在一次封装中处理更多芯片，从而提高生产效率。日月光还将在高雄建设 FOPLP 生产线，2024 年投入 2 亿美元（约 14.5 亿元人民币）用于采购相关设备，预计机台今年下半年进驻，今年底试产后，明年启动向客户送样。若进展顺利，未来将收获订单并实现量产出货。此外，日月光在 18 日宣布马来西亚槟城五厂正式启用。该工厂的启用大幅提升了公司在当地的产能，从中期来看，预计会使日月光在当地的雇员规模增加 1500 人。从长期规划而言，日月光打算将马来西亚厂区的整体规模从 9.29 万平方米扩大到 31.59 万平方米。

私募巨头银湖资本正与英特尔进行谈判，计划收购其可编程芯片部门 Altera 的多数股权。据 IT 之家 2 月 19 日消息，彭博社当日发布报道，私募巨头银湖资本正与英特尔深入谈判收购其可编程芯片部门 Altera 多数股权事宜，目前谈判已进入后期阶段，但具体股权比例尚未确定。消息人士指出，谈判存在变数，可能延迟甚至失败，英特尔和银湖资本均对该消息保持沉默。受此消息影响，英特尔股价在周二一度飙升 17%，创下近五年来最大单日涨幅，此前市场关于英特尔可能分拆并与台积电合作的猜测也助力了股价上涨，截至纽约时间下午 3:37，英特尔股价上涨约 15%，市值达约 1170 亿美元。资料显示，Altera 成立于 1983 年，主要生产可编程逻辑器件和可重复配置的复杂数字电路，提供 FPGA、SoC FPGA 和 CPLD 等产品。2015 年，英特尔斥资约 170 亿美元收购 Altera，2024 年英特尔表示在业务重组计划中考虑出售 Altera 股份。此前有报道称，莱迪思半导体等多家收购公司对 Altera 感兴趣，但部分收购方给出的估值仅 90 亿美元。

9. 风险提示

地缘政治带来的不可预测风险：随着地缘政治冲突加剧，美国等国家/地区相继收紧针对半导体行业的出口管制政策，国际出口管制态势趋严，经济全球化受到较大挑战，对全球半导体市场和芯片供应链稳定带来不确定风险。未来如美国或其他国家/地区与中国的贸易摩擦升级，限制进出口及投资，提高关税或设置其他贸易壁垒，半导体行业相关公司还可能面临相关受管制设备、原材料、零备件、软件及服务支持等生产资料供应紧张、融资受限的风险等，进而对行业内公司的研发、生产、经营、业务造成不利影响。

需求复苏不及预期：受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，集成电路行业存在一定的周期性，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，集成电路行业的市场需求也将随之受到影响。另外，下游市场需求的波动和低迷亦会导致集成电路产品的需求下降，或由于半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求。

技术迭代不及预期：集成电路行业属于技术密集型行业，集成电路涉及数十种科学技术及工程领域学科知识的综合应用，具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点。多年来，集成电路行业公司坚持自主研发的道路并进一步巩固自主化核心知识产权。如果行业内公司未来技术研发的投入不足，不能支撑技术升级的需要，可能导致公司技术被赶超或替代，进而对公司的持续竞争力产生不利影响。

产业政策变化风险：集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的

战略性产业。国家陆续出台了包括《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)在内的一系列政策,从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等方面为集成电路企业提供了更多的支持。未来如果国家相关产业政策出现重大不利变化,将对行业发展产生一定不利影响。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区德胜国际中心 B 座 11 层	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋 23 层 2301 房	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100088	邮编：570102	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	电话：(0898)-65365390 邮箱：research@tfzq.com	电话：(8621)-65055515 传真：(8621)-61069806 邮箱：research@tfzq.com	电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com